

中国集成电路零部件创新联盟

集零盟发〔2023〕4号

关于举办半导体零部件产业协同创新发展 沈阳峰会的通知

联盟各成员单位：

半导体零部件是半导体产业的“基石”，是保障半导体装备供应链以及整个产业链安全稳定运行的战略支点。为加快推进我国半导体零部件产业协同创新发展，实现高水平科技自立自强，保障我国半导体产业链供应链自主可控，在中国集成电路创新联盟的指导下，中国集成电路零部件创新联盟、中国集成电路装备创新联盟、高端数控机床创新联盟定于5月6日举办半导体零部件产业协同创新发展沈阳峰会。现将本次会议情况通知如下：

一、会议时间

2023年5月6日 09:00-18:00

二、会议地点

辽宁友谊宾馆1号楼二楼迎宾厅（沈阳市皇姑区黄河北大街1号）

三、组织单位

指导单位：中国集成电路创新联盟

主办单位：中国集成电路零部件创新联盟、中国集成电路装备创新联盟、高端数控机床创新联盟

协办单位：辽宁省半导体行业协会、沈阳 IC 装备产业技术创新战略联盟、沈阳市数字经济企业协会、沈阳产业技术研究院

四、报名须知

请参会嘉宾于 4 月 24 日 17 点前将参会回执（附件 5）发送至邮箱 **zhugj@icctia.cn**，往来交通、住宿费用自理。

联系人：朱国精 13651218851

五、附件

- 附件：1.半导体零部件产业协同创新发展沈阳峰会日程
2.长鑫存储装备零部件供应链供需对接会日程
3.零部件联盟与数控机床联盟供需对接会日程
4.沈阳市集成电路产业链项目合作对接会日程
5.沈阳市对接会邀请函

中国集成电路零部件创新联盟

2023 年 4 月 21 日

附件 1

半导体零部件产业协同创新发展沈阳峰会日程

时 间	会议内容
08:00-08:50	入场签到
09:00-09:05	介绍与会嘉宾、会议背景
09:05-09:35	致辞讲话： 1. 沈阳市政府领导 2. 辽宁省政府领导 3. 科技部重大专项司领导
09:35-09:50	辽宁省集成电路产业发展情况及未来规划报告
09:50-11:30	主题报告： 1. 叶甜春 中国集成电路创新联盟副理事长兼秘书长、 国家科技重大专项 02 专项技术总师 2. 秦平祥 长鑫存储技术有限公司常务副总裁 3. 赵晋荣 中国集成电路装备创新联盟理事长 4. 雷震霖 中国集成电路零部件创新联盟理事长 5. 刘炳业 高端数控机床创新联盟秘书长
11:30-12:40	自助午餐
13:00-15:50	长鑫存储装备零部件供应链供需对接会(日程见附件 2)
13:30-15:50	零部件联盟与数控机床联盟供需对接会(日程见附件 3)
16:00-18:00	沈阳市集成电路产业链项目合作对接会(日程见附件 4)
18:00-20:00	晚餐

附件 2

长鑫存储装备零部件供应链供需对接会日程

时间	会议内容
12:40-12:50	入场签到
13:00-13:05	主持人：李超波 中国集成电路零部件创新联盟秘书长 介绍与会嘉宾、会议背景
13:05-13:20	长鑫存储专题报告 赵国胜 长鑫存储设备开发与维修部负责人
13:20-15:30	分组对接： 第一组：长鑫存储、装备企业、零部件企业 第二组：长鑫存储、装备企业、零部件企业 第三组：长鑫存储、装备企业、零部件企业
15:30-15:45	小组组长汇报对接成果
15:45-15:50	会议总结

附件 3

零部件联盟与高端数控机床联盟供需对接会日程

时间	会议内容
13:00-13:20	入场签到
13:30-13:35	主持人：刘志峰 高端数控机床创新联盟副秘书长 介绍与会嘉宾、会议背景
13:35-13:50	致辞讲话： 1. 刘炳业 高端数控机床创新联盟秘书长 2. 雷震霖 中国集成电路零部件创新联盟理事长 3. 领导讲话
13:50-14:30	主题报告： 1. 中国集成电路零部件创新联盟情况及参会企业介绍 2. 高端数控机床创新联盟情况及参会企业介绍
14:30-15:45	自由讨论交流
15:45-15:50	会议总结

附件 4

沈阳市集成电路产业链项目合作对接会日程

时间	会议内容
16:00-16:05	主持人介绍与会领导、嘉宾、会议背景
16:05-16:10	沈阳市政府领导致辞
16:10-16:30	1. 沈阳市集成电路产业链工作专班负责人介绍《沈阳市集成电路装备产业链规划》 2. 沈阳市高新技术开发区负责人介绍《北方国际芯谷规划》
16:30-17:00	沈阳重点企业介绍联合技术攻关、零部件采购、产品推广需求情况
17:00-17:45	优秀企业介绍拟投资项目、设备及零部件供给情况
17:45-18:00	签约仪式

附件 5

沈阳市人民政府

邀请函

各联盟成员单位：

中国集成电路零部件创新联盟、中国集成电路装备创新联盟、高端数控机床创新联盟将于 2023 年 5 月 6 日举办半导体零部件产业协同创新发展沈阳峰会。届时，沈阳市政府将按照峰会统一安排，主办沈阳市集成电路产业链项目合作对接会。

在此，我们诚挚地邀请贵单位参加沈阳市对接会，共谋发展策略，共图科技自立自强，共同推动国家集成电路产业发展。

特此致函。

附件：沈阳市集成电路产业链项目合作对接会活动方案



(联系人：于健 宋东逊 电话：13591648126 18640516104)

附件

沈阳市集成电路产业链项目合作对接会 活动方案

2023年5月6日，中国集成电路零部件创新联盟、中国集成电路装备创新联盟、高端数控机床创新联盟将举办半导体零部件产业协同创新发展沈阳峰会，在此期间，沈阳市政府将主办召开沈阳市集成电路产业链项目合作对接会。

一、会议时间

2023年5月6日 16:00-18:00

二、会议地点

辽宁友谊宾馆1号楼二楼迎宾厅（沈阳市皇姑区黄河北大街1号）

三、组织单位

（一）主办单位：沈阳市人民政府

（二）承办单位：沈阳市集成电路产业链工作专班、沈阳高新技术开发区

（三）协办单位：沈阳数字经济企业协会、拓荆科技股份有限公司、芯源微电子设备股份有限公司、和研科技股份有限公司、中科院沈阳科学仪器股份有限公司等。

四、参会人员

（一）省、市政府领导及有关部门领导

(二) 辽沈地区和国内其他地区半导体装备及零部件等企业代表等

五、日程安排

主 持 人：沈阳市政府领导

16:00—16:05 主持人介绍与会领导、嘉宾

16:05—16:10 沈阳市政府领导致辞

16:10—16:30 沈阳市集成电路产业链工作专班负责人

介绍《沈阳市集成电路装备产业链》；

沈阳高新技术开发区负责人介绍《北方国际芯谷规划》

16:30—17:00 拟请拓荆科技、芯源微、和研科技等沈阳重点企业介绍联合技术攻关、零部件采购、产品推广需求情况

17:00—17:45 外埠优秀企业介绍拟投资项目、设备及零部件供给情况

17:45-18:00 签约仪式

18:00-19:00 晚餐